



Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

ZSC31050FAC

Număr parc	ZSC31050FAC
Producator / Marca	IDT (Renesas Electronics Corporation)
Descriere produs	DICE (WAFER SAWN) - FRAME
Foi de date	

Statutul RoHs	
Starea stocului	4064 pcs stock
Barca din	Hong Kong
Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de ZSC31050FAC

Serie	*	Pachet	Tray
Numărul produsului de bază	ZSC31050		

Vești înrudite



Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii singur modul

2023/08/22

2023/03/16

Placa Triple Display Atom X7000 primește 4x 2,5 git/s Ethernet și 2x RS-485

2023/08/31

2023/08/21

SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/07/4

2023/08/16

2023/03/15

Sursa de alimentare de 12V sau 48V livrează vârfuri de 800W

Infineon încearcă PCB -uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului

2023/09/13

2023/07/28

2023/08/17

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/08/7

2023/09/15